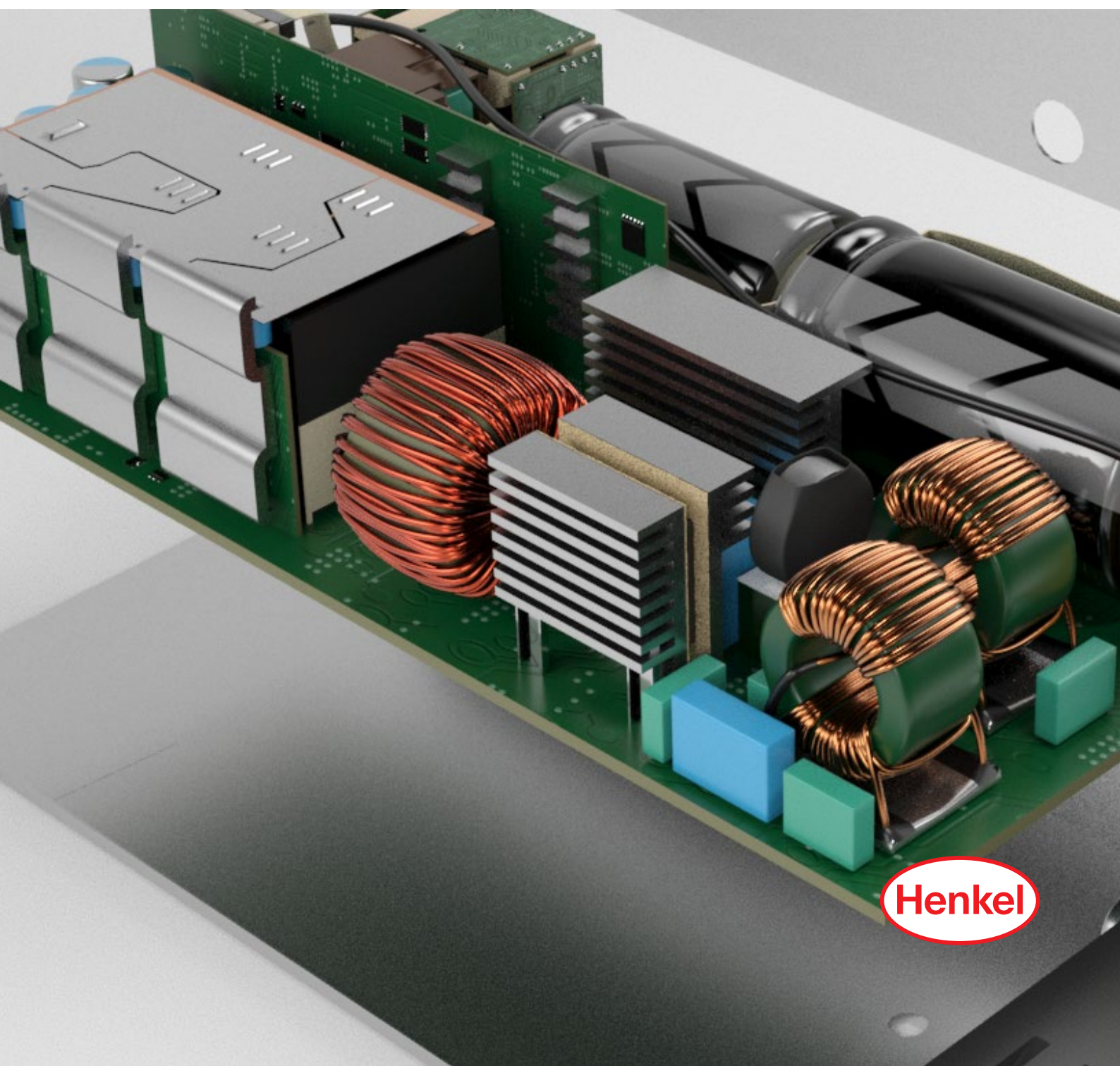


用于电源与转换器的材料

电源与转换器解决方案



目录

电源介绍

AC/DC材料解决方案

DC/DC材料解决方案.....

电力设备材料

热管理材料

保护材料

粘接材料

3

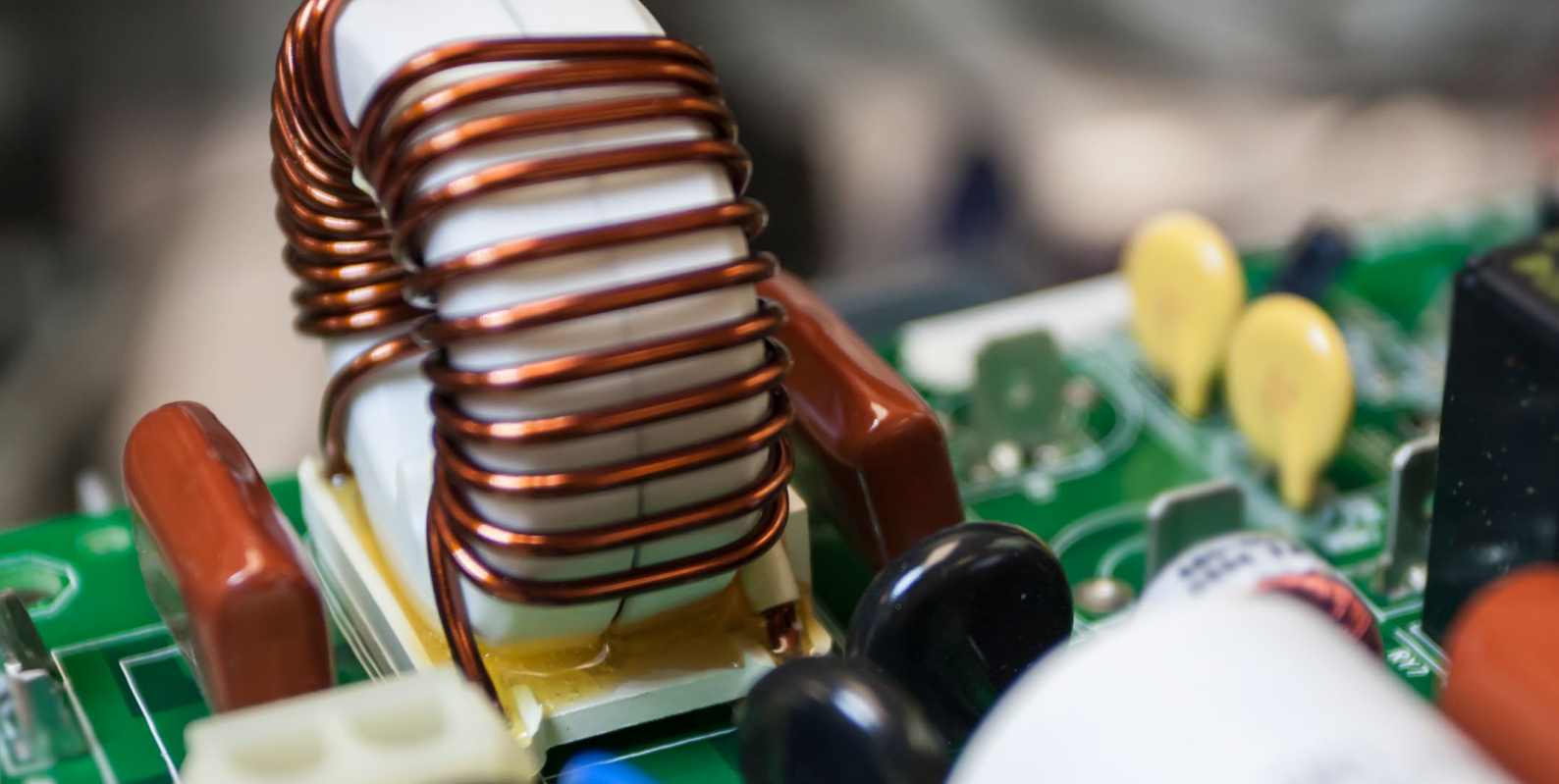
4

5

6

13

16



电源介绍

工业电子产品对于电源的需求是巨大的。在不影响可靠性或提高成本的情况下，为在更小的尺寸下获得更高功率和更多功能的需求，正在推动制造商转向性能更强的材料和工艺。作为具有成熟产品性能的全球合作伙伴，汉高的电子材料系列可帮助设计人员实现这些目标。

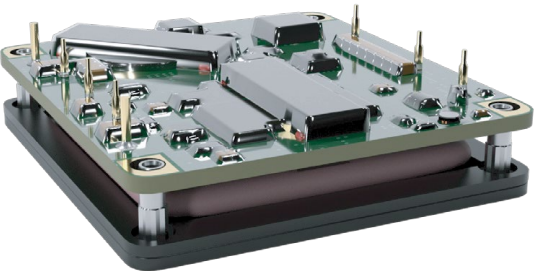
AC/DC电源转换

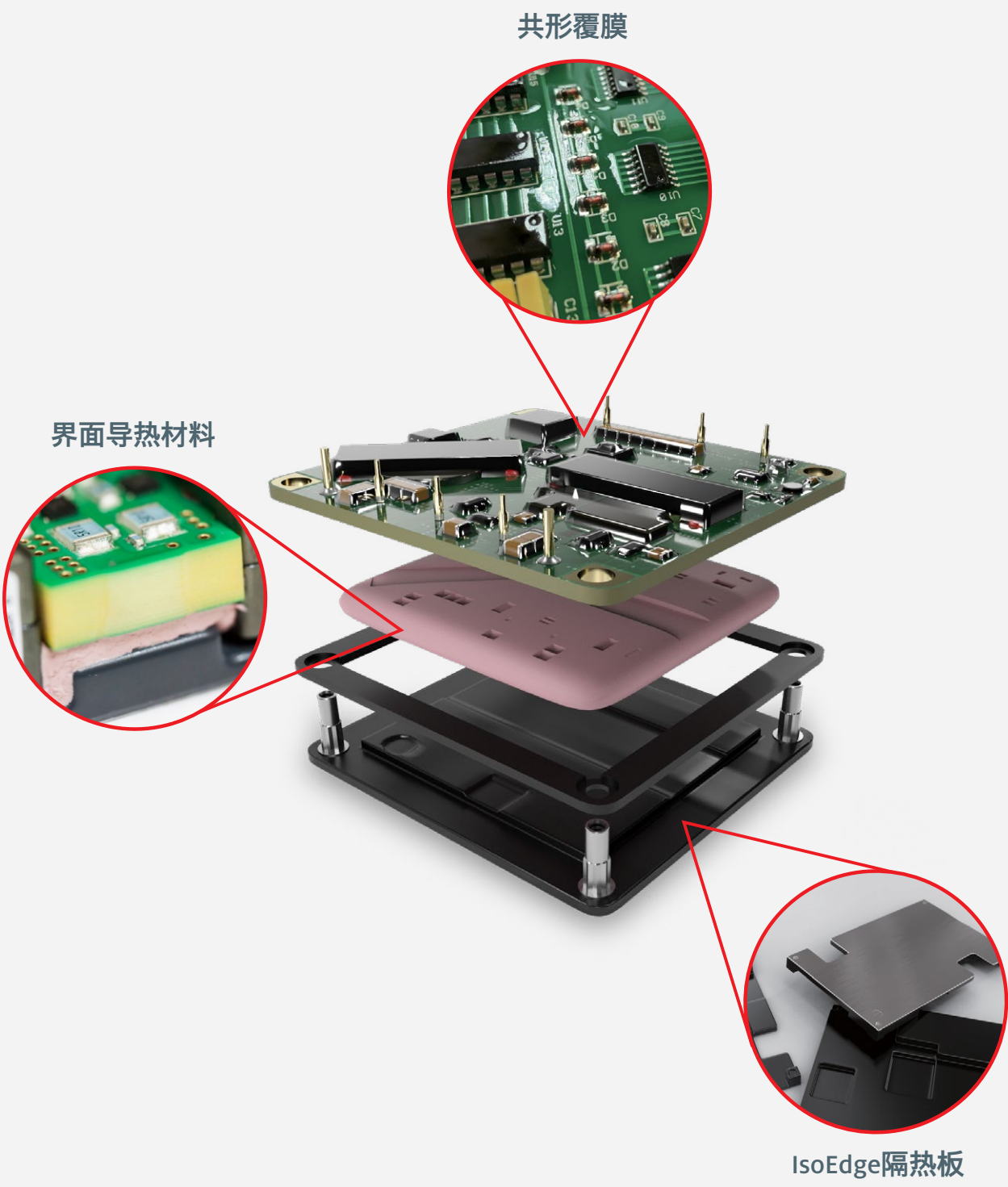
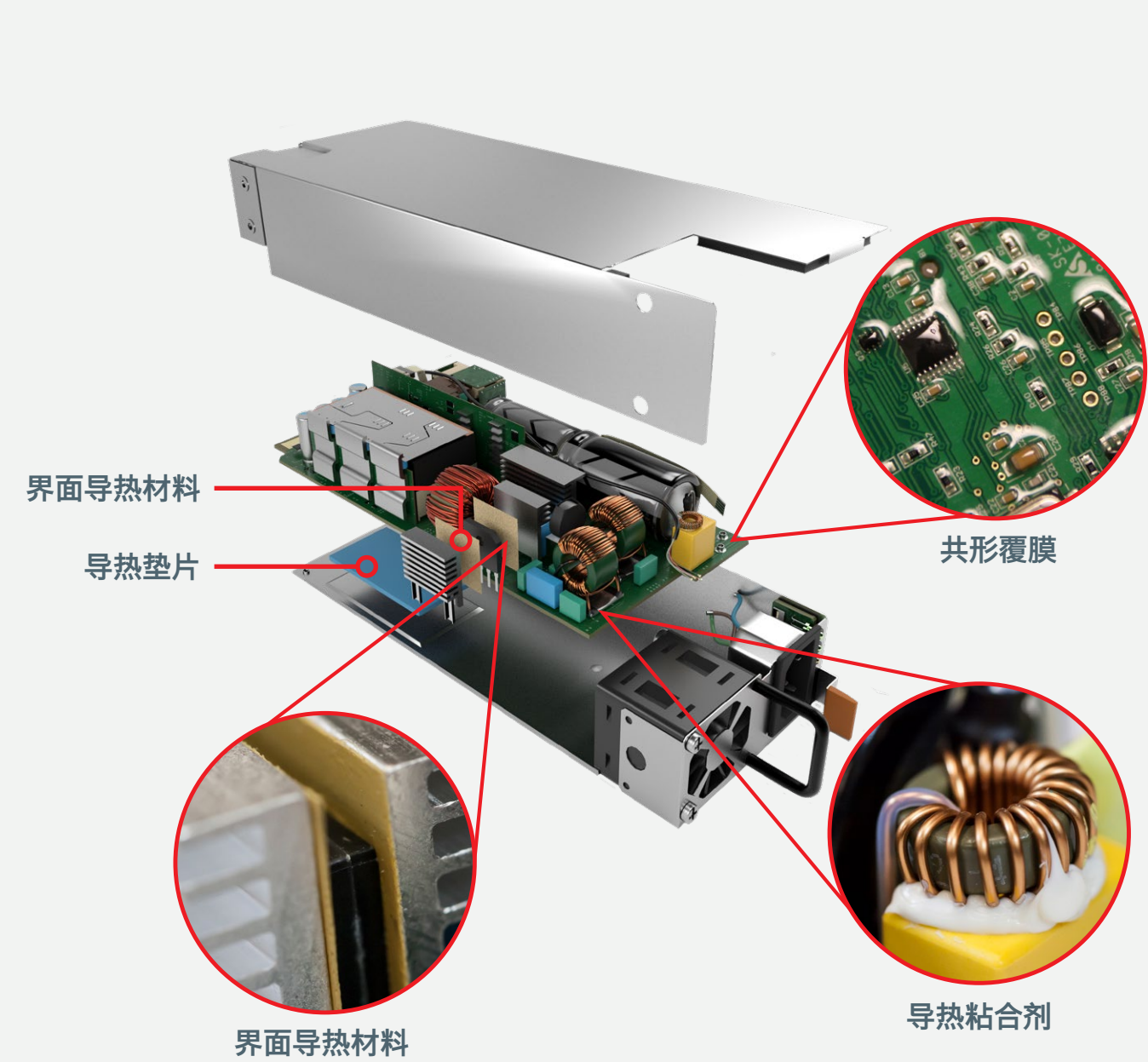
AC/DC电源用于将AC配电电源转换为DC电源以供终端应用、配电系统和替代能源设备使用。新型电子材料促进了设计和能力的提高，使这些重要的电子系统更小，更便携，功能更强大并且具有非常高的可靠性。汉高材料在生产AC/DC电源方面发挥着关键作用，确保电气连接安全、结构耐用且功能可靠。



DC/DC电源转换

利用电子系统实现高效的电力分配，DC/DC电源转换器在恒压下可处理更高功率、更高效地运行并保持高可靠性标准。汉高材料作为实现这些目标的核心组件，可以设计和制造具有更高功率密度、更高可靠性的DC/DC转换器，并同时降低成本。





界面导热材料

SIL PAD®绝缘垫片

产品名称	描述	关键属性	导热性 (W/m·k)	硬度	电介质 击穿电压	厚度 (mm)	易燃性
BERGQUIST® SIL PAD® TSP 1600	高柔顺度的垫片，在低压力安装下提供高导热性能与电气绝缘性能	• 热阻抗：0.45° C-in²/W (50 psi) • 高价值材料 • 平滑且高度柔顺的表面 • 电绝缘	1.6	91 (Shore A)	3,000	0.127	UL 94 V-0
BERGQUIST® SIL PAD® TSP 1600S	在低压力安装下提供高导热性能与电气绝缘性能的绝缘材料	• 热阻抗：0.61° C-in²/W (50 psi) • 电绝缘 • 低安装压力 • 平滑且高度柔顺的表面 • 通用界面导热材料解决方案	1.6	92 (Shore A)	5,500	0.229	UL 94 V-0
BERGQUIST® SIL PAD® TSP K1800ST	玻璃纤维加固材料，两侧都有粘性，适用于大批量装配	• 热阻抗：0.23° C-in²/W (50 psi) • 两侧自然粘性 • 可重新定位的垫片 • 优秀的导热性能 • 自动放置与可分切	1.8	75 (Shore 00)	3,000	0.203	UL 94 V-0
BERGQUIST® SIL PAD® TSP K900	为高压专门开发的薄膜，不需要导热硅脂	• 热阻抗：0.48° C-in²/W (50 psi) • 承受高压 • 高绝缘强度 • 非常耐久	0.9	90 (Shore 00)	6,000	0.152	UL 94 VTM-0
BERGQUIST® SIL PAD® TSP K1100	涂有硅氧烷弹性体的中等性能薄膜，提供强大的绝缘屏障	• 热阻抗：0.49° C-in²/W (50 psi) • 强大的绝缘屏障，防止穿透 • 中等性能薄膜	1.1	90 (Shore 00)	6,000	0.152	UL 94 VTM-0
BERGQUIST® SIL PAD® TSP K1300	替代氧化铍，氮化硼和氧化铝等陶瓷绝缘体的高性能绝缘体	• 热阻抗：0.41° C-in²/W (50 psi) • 坚固的绝缘屏障，防止穿透 • 高性能薄膜 • 为取代陶瓷绝缘体设计	1.3	90 (Shore 00)	6,000	0.152	UL 94 VTM-0
BERGQUIST® SIL PAD® TSP Q2000	玻璃纤维加固的油硅脂替代品，可以承受加工应力，保证物理完整性并且在应用期间提高操作便捷性	• 热阻抗：0.35° C-in²/W (50 psi) • 消除通常与硅脂相关的加工限制 • 顺从表面纹理 • 易于处理 • 可在焊接和清洁之前安装，无需担心	2.0	86 (Shore A)	不绝缘	0.127	UL 94 V-0
BERGQUIST® SIL PAD® TSP Q2500	两面涂有导热/导电橡胶的铝箔，适合需要最高热传导并且不需要电绝缘的应用	• 热阻抗：0.22° C-in²/W (50 psi) • 最大导热性能 • 双面涂层铝箔 • 为取代导热硅脂设计	2.5	93 (Shore A)	不绝缘	0.152	UL 94 V-0

GAP PAD®导热垫片

产品名称	描述	关键属性	导热性 (W/m·k)	硬度	电介质 击穿电压	厚度 (mm)	易燃性
BERGQUIST® GAP PAD® TGP 1350	具有高度柔性的间隙填充材料	• 永久性的薄膜加固，允许更简易的返工，提高耐穿刺和撕裂能力 • 高度共形能力/低硬度 • 为低应力设计	1.3	110	在500 µm下 6000V	0.508 – 3.175	UL 94 V-0
BERGQUIST® GAP PAD® TGP 1000VOUS	导热间隙填充材料	• 高共形能力、低硬度 • “凝胶”类模量 • 减少压力 • 耐刺穿、剪切和撕裂性能 • 不导电	1.0	55	在500 µm下 6000V	0.508 – 6.350	UL 94 V-0
BERGQUIST® GAP PAD® TGP HC3000	导热间隙填充材料	• 高顺应性，低压缩应力 • 玻璃纤维增强抗剪切和抗撕裂性 • 低模量	3.0	110	在500 µm下 5000V	0.508 – 3.175	UL 94 V-0
BERGQUIST® GAP PAD® TGP HC5000	导热间隙填充材料	• 高共形能力 • 出色的导热性能 • 高顺应性，低压缩应力 • 玻璃纤维加固，提高剪切与撕裂耐性 • 低模量	5.0	121	在500 µm下 5000V	0.508 – 3.175	UL 94 V-0
BERGQUIST® GAP PAD® TGP 6000ULM	高导热性能，超低模量间隙填充材料	• 导热性：6.0 W/m·K • 高顺应性，低压缩应力 • 超低模量	6.0	41	在500 µm下 5000V	1.524 – 3.175	UL 94 V-0
BERGQUIST® GAP PAD® TGP 7000ULM	高导热性能，超低模量间隙填充材料	• 导热性：7.0 W/m·K • 高共形能力，非常低的压缩应力 • 在应用最小应力的情况下共形并保持结构整体性	7.0	28	在500 µm下 5000V	1.016 – 3.175	UL 94 V-0

液态填隙材料

产品名称	描述	关键属性	导热性 (W/m·k)	粘度 25 °C (cP)	介电强度 (V/25 µm)	建议 固化方式	易燃性
BERGQUIST® GAP FILLER TGF 1500	双组份，高性能导热液态间隙填充材料	• 优化剪切变稀特性，使其易于点胶 • 出色的抗塌落性 (保持原有位置) • 具有出色的浸润性能和超高的共形能力，适用于低应力界面应用 • 100%固体 - 无固化副产物 • 出色的低温和高温机械和化学稳定性	1.8	250,000	400	25 °C 5/小时	UL 94 V-0
BERGQUIST® GAP FILLER TGF 1500LVO	双组份，高性能导热液态间隙填充材料，非常低的硅排放量	• 导热性：1.8 W/m·K • 低挥发性，应用于对有机硅敏感的应用中 • 超级良好的共形能力，具有出色的浸润性 • 100%固体 - 无固化副产物 • 出色的低温和高温机械和化学稳定性	1.8	20,000	400	25 °C 8/小时	UL 94 V-0

界面导热材料

液态填隙材料 – 续

产品名称	描述	关键属性	导热性 (W/m·k)	粘度 25 °C (cP)	介电强度 (V/25 µm)	建议 固化方式	易燃性
BERGQUIST® GAP FILLER TGF 3600	导热液态间隙 填充材料	• 高导热性能 • 触变特性，易于涂胶 • 超高共形能力，为脆弱、低应力应用设计 • 室温或加速固化	3.6	150,000	275	25 °C 15小时	UL 94 V-0
BERGQUIST® GAP FILLER TGF 3500LVO	导热、低挥发 液态间隙填充 材料	• 低挥发性材料，适用于对挥发物敏感应用 • 超高共形能力，优秀的湿润特性，适用于低应力界面应用 • 100%固体，无固化副产品 • 室温或加速固化	3.5	45,000	275	25 °C 24小时	UL 94 V-0
BERGQUIST® GAP FILLER TGF 4000	双组份高性能 导热液态间隙 填充材料	• 导热性能：4.0 W/m·K • 更长的工作时间，提高生产灵活性 • 超高共形能力，优秀的湿润性 • 100%固体，无固化副产品 • 优秀的低温和高温化学与机械稳定性	4.0	50,000	450	25 °C 24小时	UL 94 V-0
BERGQUIST® GAP FILLER TGF 4500CVO	双组份高性能 导热液态间隙 填充材料	• 热导率：4.5 W/mK • 延长工作时间以提高制造灵活性 • 可控挥发性有机硅 • 高分配合吞吐量 • 优化自动点胶过程的粘度	4.5	20,000	-	25 °C 48小时	UL 94 V-0
BERGQUIST® GAP FILLER TGF 3000SF	双组份室温 固化填缝胶 适用于高产量 组装应用	• 热导率：3.0 W/m·K • 可分配液体，双组份无硅填隙剂 • 室温固化 - 无需烤箱 • 极高的点胶率：取决于设备 • 装配过程中的低压缩应力	3.0	22,000	-	25 °C, 72小时或 85 °C, 3小时	UL 94 V-0

LIQUI FORM导热凝胶

产品名称	描述	关键属性	导热性 (W/m·k)	体积电阻率 (Ω·m)	介电强度 (V/25 µm)	涂胶速度 (grams/min.)	易燃性
BERGQUIST® LIQUI FORM TLF LF3500	单组分、高度 共形、具有触 变属性的导热 凝胶	• 导热性：3.5 W/m·K • 可以进行点胶的预固化凝胶 • 在储存和应用中保持稳定的 粘度 • 优秀的化学稳定性和机械稳 定性	3.5	1 x 10 ¹¹	250	40	UL94 V-0

界面导热材料 – 续

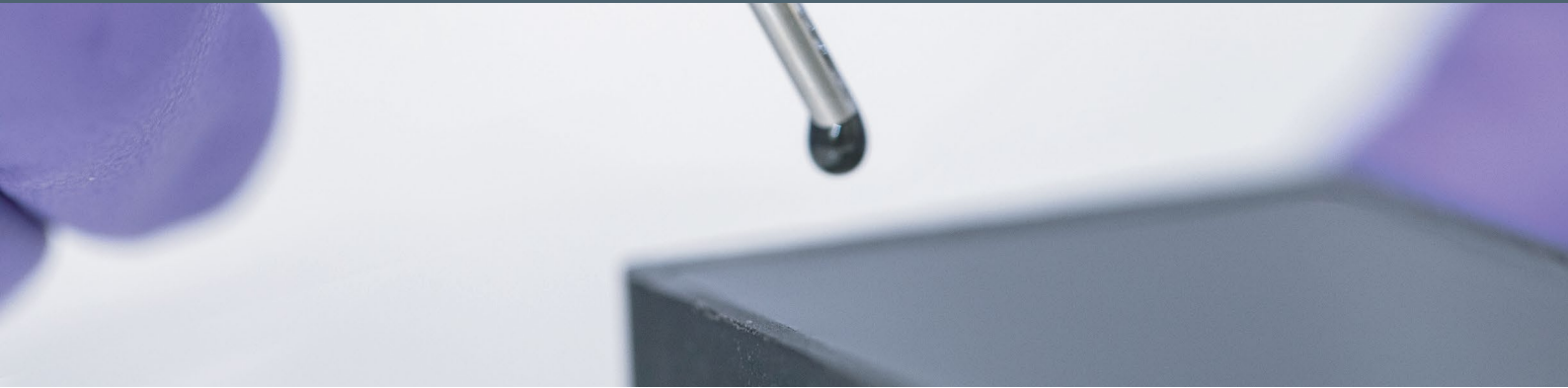
LIQUI BOND导热粘接

产品名称	描述	关键属性	导热性 (W/m·k)	粘度 25 °C (cP)	介电强度 (V/25 µm)	厚度 (mm)	易燃性
BERGQUIST® LIQUI BOND TLB EA1800	双组份，环 氧基触变液 体可点胶粘 合剂	• 室温固化 • 室温储存 • 导热系数：1.8 W/m·K • 无需机械紧固 • 在极端的环境下应用仍保持 结构粘接 • 优秀的化学与机械稳定性	1.8	61,000	250	25 °C, 10小时或 125 °C, 10分钟	UL 94 V-0
BERGQUIST® LIQUI BOND TLB SA2000	高性能导热 单组分液体 硅胶，固化 后形成固体 粘接弹性体	• 高导热系数：2.0 W/m·K • 无需机械紧固 • 单组分配方，易于点胶 • 机械与化学稳定性 • 在极端的环境下应用仍保持 结构粘接 • 加热固化	2.0	200,000	250	125 °C 20分钟	UL 94 V-0
BERGQUIST® LIQUI BOND TLB SA2005RT	双组份高性 能导热硅 胶，可接受 从25至180度 不同固化方 案	• 导热系数：2.0 W/m·K • 适合热固化 • 没有固化副产品 • 室温固化与粘接 • 高温下固化速度大大加快 • 室温储存	2.0	70,000	275	25 °C, 7天或 85 °C, 1小时	UL 94 V-0

相变材料

产品名称	描述	关键属性	导热性 (W/m·k)	体积电阻率 (Ω·m)	介电 击穿电压	厚度 (mm)	易燃性
BERGQUIST® HI FLOW THF 1600G	本材料是由涂在玻璃纤维网 上的55 °C相变化合物组成 的。本产品是作为电脑处理 器和散热器之间的界面导热 材料设计的	• 热阻抗：0.20 °C·in² / W (25 psi) • 不会像硅脂一样溢出或跑掉 • 相变化合物涂在玻璃纤维载 体上	1.6	1 x 10 ⁸	300	0.127	UL 94V-0
BERGQUIST® HI FLOW THF 1500P	导热相变材料，采用聚酰亚 胺薄膜进行加固，提供高绝 缘强度和抗切割属性	• 热阻抗：0.20 °C·in²/W (25 psi) • 150 °C 高温可靠性 • 一侧具有天然粘性，易于装配 • 在绝缘垫上有着优秀的热性能	1.5	1 x 10 ¹²	5,000	0.114 – 0.140	UL 94V-0

AC/DC & DC/DC的保护性材料



相变材料(续)

产品名称	描述	关键属性	导热性 (W/m·k)	体积电阻率 (Ω·m)	介电 击穿电压	厚度 (mm)	易燃性
BERGQUIST® HI FLOW THF 1600P	涂有55 °C相变导热化合物的聚酰亚胺薄膜	• 热阻抗0.13 °C·in²/W (25 psi) • 经过现场验证的聚酰亚胺薄膜，具有出色的绝缘性能和抗切割性 • 在绝缘垫上有着优秀的热性能	1.6	1 x 10 ¹²	5,000	0.102 – 0.127	UL 94V-0

产品名称	描述	相变温度	导热性 (W/m·k)	比重	建议干燥环境
LOCTITE® TCP 4000 PM	可返工、可重复相变材料，适用于在发热设备与之安装的表面或其他散热表面之间使用	45°C	3.4	2	.051 mm 厚度：22 °C，20小时 60 °C，22分钟；125 °C，3分钟

BOND PLY系列胶带

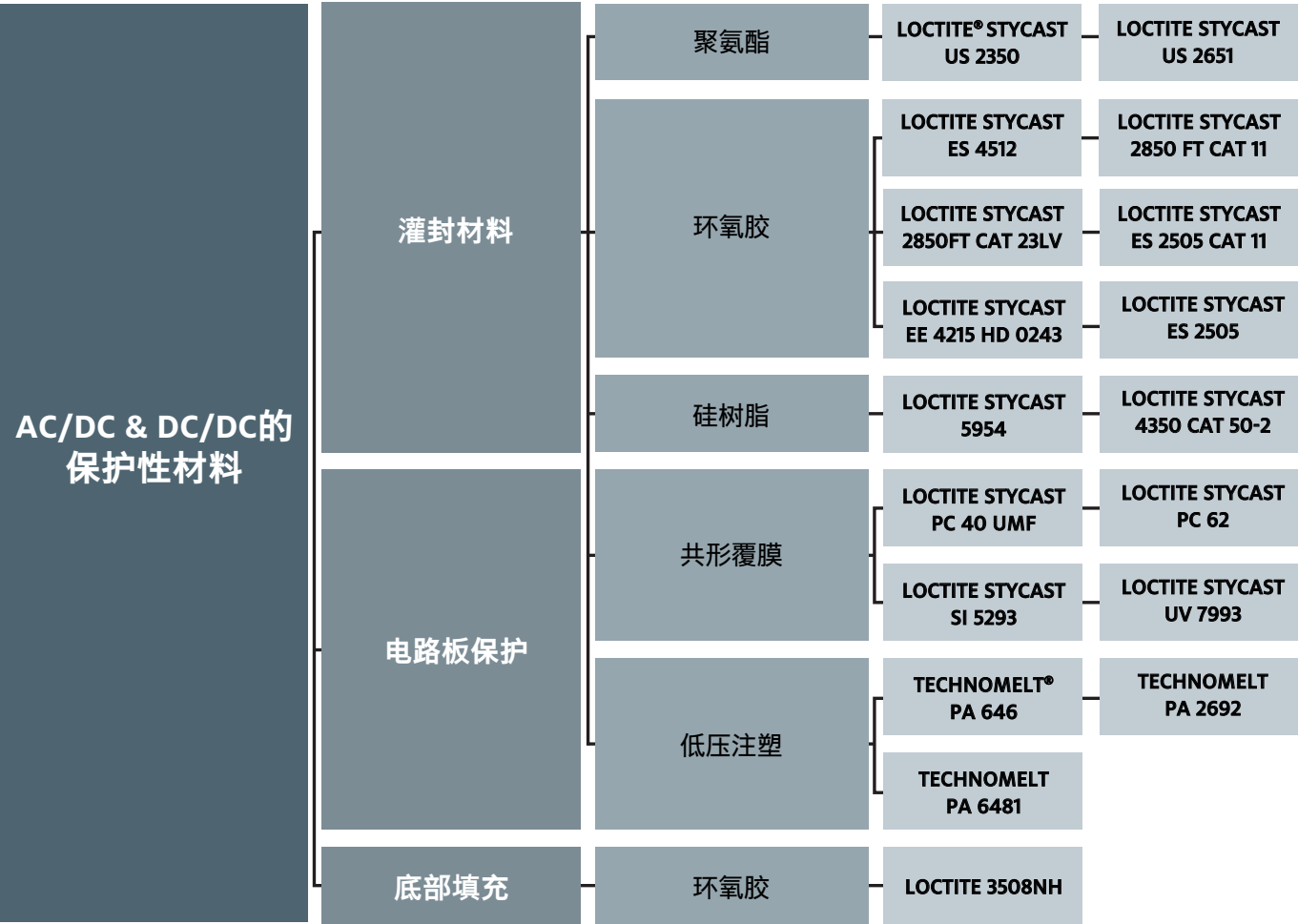
产品名称	描述	关键属性	导热性 (W/m·k)	介电 击穿电压	厚度 (mm)	建议 固化方式	易燃性
BERGQUIST® BOND PLY TBP 1400 LMS-HD	导热，可进行加热固化的层压材料	• T0-220热性能2.3 °C/W，初始压力仅为组合时很小的力 • 卓越的绝缘强度 • 非常低的界面阻力 • 200 psi粘接强度 • 可以在-60 – 180 °C持续使用 • 不需要机械紧固件	1.4	5,000	0.254 – 0.457	125 °C 30分钟	UL 94V-0

ISOEDGE

产品名称	描述	关键属性	导热性 (W/m·k)	介电强度 (v25µm)	介电常数 (电容率)	厚度 (mm)	易燃性
BERGQUIST® ISOEDGE TPC Black	薄的导热、电绝缘涂料，可以为散热器提供优秀的热传导和电绝缘属性	• U.L. RTI等级为130 °C • 低热阻抗2.2 °C/W (T0-220测试方式) • U.L. 认证的导热解决方案，让散热器可以非常靠近组件 • 与传统的平板散热器和垫片相比，可显著提高整体散热性能	0.6	650	6	0.102 – 0.254	UL 94 V-0

PCB和组件保护

LOCTITE®和TECHNOMELT®品牌电路板保护材料可以在恶劣的工业环境为电路板和元件提供关键的保护，增强电气互连，并提供针对电气有害条件提供长期性保护。共形覆膜可保护电子电路免受湿气，化学品和其他污染物的影响；板上芯片密封剂为精密部件提供保护屏障；底部填充剂将阵列器件的压力最小化；Technomelt 低压注塑材料为电子封装提供快速，无损的解决方案；硅树脂，环氧树脂和聚氨酯化学品中的灌封材料可提高加工灵活性和最大程度的保护。汉高的材料开发工作注重环保，专注于配制无卤，无铅，无溶剂和低VOC产品。



灌封

产品名称	固化方式	粘度 25 °C (cP)	适用寿命 25 °C	硬度	导热系数 W/m·k	温度范围	保质期
聚氨酯							
LOCTITE STYCAST US 2350	60 °C, 2小时	2,400	45分钟	85A	0.510	-65°C – 125°C	1年
LOCTITE STYCAST US 2651	25 °C, 16小时	1,000	10分钟	15A	0.180	-65°C – 125°C	1年
环氧							
LOCTITE STYCAST ES 4512	25 °C, 36-48小时 (建议固化方式) 60 °C, 3小时 (替代固化方式)	19,000	200 g 60分钟	88D	0.644	-40°C – 125°C	1年
LOCTITE STYCAST 2850FT / CAT 11	80 °C, 8-16小时 100 °C, 2-4小时 120 °C, 30-60分钟	64,000	100 g, 25 °C 1小时	96D	1.280	-55°C – 125°C	1年
LOCTITE STYCAST 2850FT / CAT 23lv	25 °C, 16-24小时 25 °C, 4-6小时 65 °C, 2-4小时	5,600	100 g, 25 °C 1小时	92D	1.100	65°C – 105°C	1年
LOCTITE STYCAST ES 2505 / CAT 11	100 °C , 4小时 (w/CAT 11)	5,000	> 4小时	72D	0.820	-55°C – 155°C	1年
LOCTITE STYCAST EE 4215 / HD 0243	80 °C, 2小时 +150 °C, 2小时	20,000 to 30,000	7 – 8小时	80 – 85D	0.480	-40°C – 180°C	6个月

产品名称	描述	颜色	固化方式	应用	储存温度	保质期
硅树脂						
LOCTITE STYCAST 5954	双组份，高填料，加成固化导热硅胶。高导热性能，不腐蚀	红色	65 °C, 4小时	包封	25 °C	25 °C, 6个月
LOCTITE STYCAST 4350/CAT 50-2	RTV缩合固化，硅橡胶灌封化合物，为灌封与包封设计	红色	25 °C, 16-24小时 65 °C, 2-4小时	灌封或包封	25 °C	25 °C, 152天

共形覆膜

产品名称	描述	关键属性	粘度 25 °C (cP)	操作温度 (° C)	体积电阻率 (Ω·cm)	颜色	建议 固化方式
LOCTITE STYCAST PC 40-UMF	聚氨酯 共形覆膜	• 单组份 • 不含VOC • 符合IPC-CC-830要求	250	-40 – 135	3.50 x 10 ¹⁶	透明	300 – 600mW/cm² 10秒 + 大气湿度下 2-3天
LOCTITE STYCAST UV 7993	聚氨酯 共形覆膜	• 单组份 • 无溶剂 • 良好的防潮性能 • 优秀的耐化学品性能	120	-40 – 130	2.20 x 10 ¹⁶	半透明 黄色	400 – 700mW/cm² 5秒 + 50%相对湿度 100小时
LOCTITE STYCAST PC 62	适用于电路板 保护应用的 快速干燥 丙烯酸酯	• 紫外线下荧光 • 提供环境与机械保护 • 不含甲苯替代品 • 更强大的韧性与耐磨性 • 可以使用烙铁或合适的溶剂 轻易地去除	50	-40 – 125	1.04 x 10 ¹⁶	无色	25 °C, 24小时
LOCTITE SI 5293	硅胶 共形覆膜	• 单组份 • 紫外线下荧光 • 可维修 • 无溶剂 • 为极端的温度环境和高可靠 性汽车应用设计	400 – 800	-40 – 200	1.00 x 10 ¹⁴	半透明 琥珀色 黄色	70mW/cm² 20-40秒 + 50%相对湿 度72小时

低压注塑

产品名称	描述	关键属性	颜色	操作温度 (° C)	肖氏硬度
TECHNOMELT PA 646	可注塑聚酰胺	• 非常适合需要强度与硬度的应用 • 适用于高温应用的良好粘接力	黑色	-40 – 125°C	92A
TECHNOMELT PA 6481	可注塑聚酰胺	• 注塑应用 • 材料配方具有更高的UV稳定性 • 特别适合户外应用	黑色	-40 – 130°C	93A
TECHNOMELT PA 2692	可注塑聚酰胺	• 适用于高湿度应用 • 低水分传输配方	琥珀色	-40 – 150°C	88A

底部填充剂

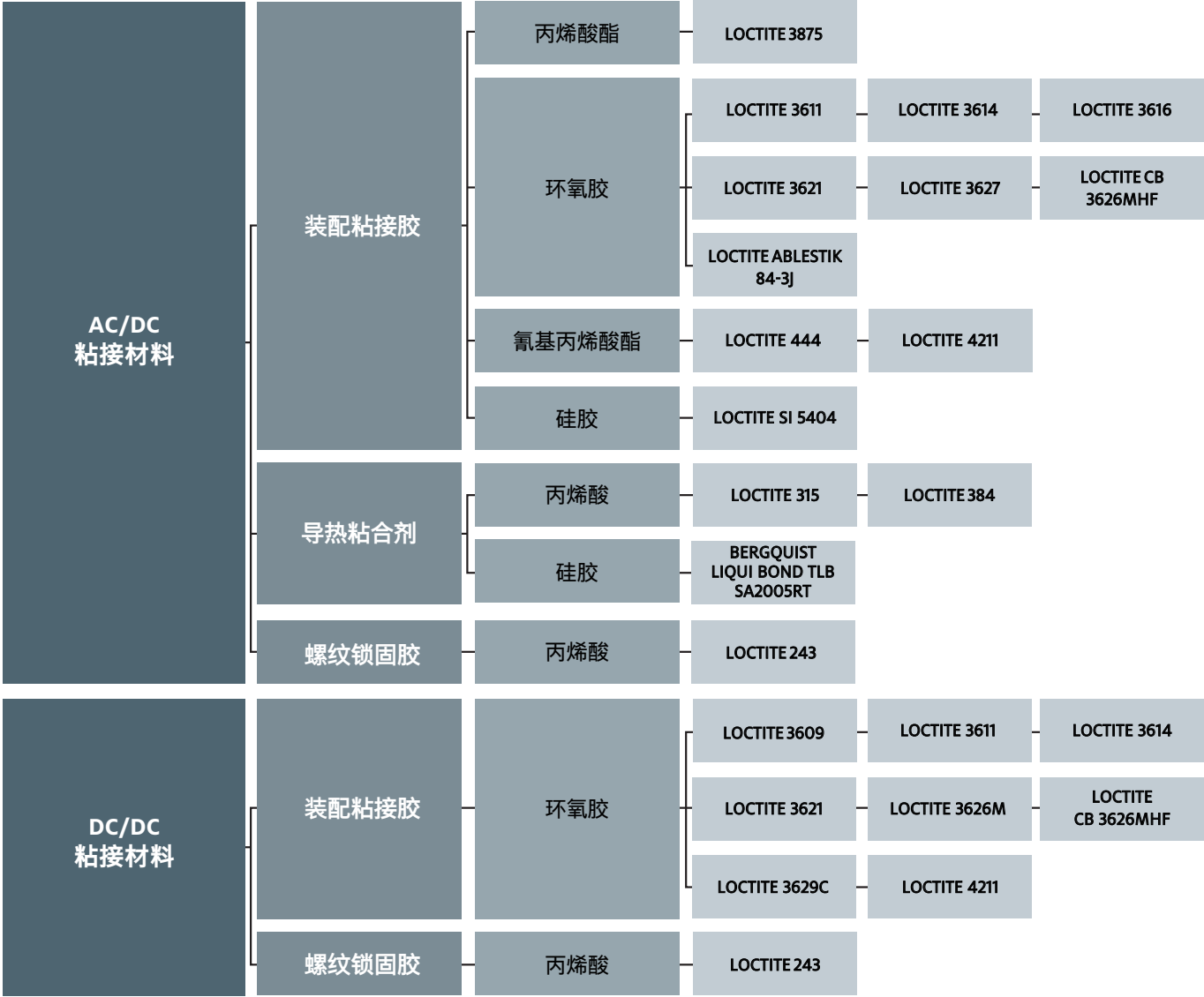
边角粘接底部填充

产品名称	描述	关键属性	粘度 25 °C (cP)	玻璃态 转变温度 Tg (° C)	热膨胀系数CTE (ppm/ ° C)		适用时间	建议 固化方式
					低于Tg	高于Tg		
LOCTITE 3508NH	可返修四角填充剂，为无铅回流设计，同时允许IC元件自对准	• 单组份 • 可回流固化 • 消除回流后的涂胶与固化步骤 • 可返工 • 无卤素	70,000	118	65	175	25 °C 30天	245 °C, 无铅 焊料回流期间 固化

AC/DC & DC/DC粘接材料

简化结构完整性

LOCTITE®粘合剂通过提供可靠，牢固的粘接，简化了多个制造步骤，并且不需要使用螺钉或夹具等机械硬件，从而降低了加工成本和设备占地面积。多种粘合剂和密封剂解决方案组合可为要求苛刻的电源转换应用提供适应性和可定制的粘接技术。从用于混合和双面SMT应用的Chipbonder和ECCOBOND粘合剂到用于结构粘合元件和PCB到散热片的BERGQUIST® BOND PLY材料，汉高的粘接解决方案系列可确保所有部件牢固连接，实现持久的产品完整性，工艺流程 也进行了优化，达到了最高效率。



装配粘接胶

产品名称	描述	化学性	颜色	固化速度	应用	储存温度
丙烯酸酯						
LOCTITE 3875	Bead-on-bead,导热粘合剂，为结构粘接散热器与散热电子组件设计	丙烯酸酯	A组份 - 浅黄色 B组份 - 淡蓝色	23 °C, 50% RH 24-72/小时	热管理	最佳储存条件 (A组份) : -20 °C 其他储存条件 (A组份) : 2 - 8 °C 最佳储存条件 (B组份) : 2 - 8 °C
环氧胶						
LOCTITE 3609	为在波峰焊接前粘接表面贴装元件和印刷电路板设计	环氧胶	深色 红色粘稠凝胶	150 °C, 90-120秒	表面安装粘合剂	2 - 8 °C
LOCTITE 3611	为在波峰焊接前粘接表面贴装元件和印刷电路板设计	环氧胶	红色粘稠凝胶	150 °C, 90-120秒	表面安装粘合剂	2 - 8 °C
LOCTITE 3614	为在波峰焊接前粘接表面贴装元件和印刷电路板设计	环氧胶	红色粘稠凝胶	150 °C, 90-120秒	表面安装粘合剂	2 - 8 °C
LOCTITE 3616	为在波峰焊接前粘接表面贴装元件和印刷电路板设计	环氧胶	红色粘稠膏	150 °C, 90-120秒	表面安装粘合剂	2 - 8 °C
LOCTITE 3621	为在波峰焊接前粘接表面贴装元件和印刷电路板设计	环氧胶	红色粘稠凝胶	150 °C, 90-120秒	表面安装粘合剂	2 - 8 °C
LOCTITE 3626M	为在波峰焊接前粘接表面贴装元件和印刷电路板设计	环氧胶	红色类凝胶材料	130 °C下至少120秒或在胶层150 °C, 90秒	表面安装粘合剂	2 - 8 °C
LOCTITE CB 3626MHF	为在波峰焊接前粘接表面贴装元件和印刷电路板设计	环氧胶	红色类凝胶材料	150 °C, 30分钟	原件组装 NCA 表面安装粘合剂	2 - 8 °C

装配粘接胶(续)

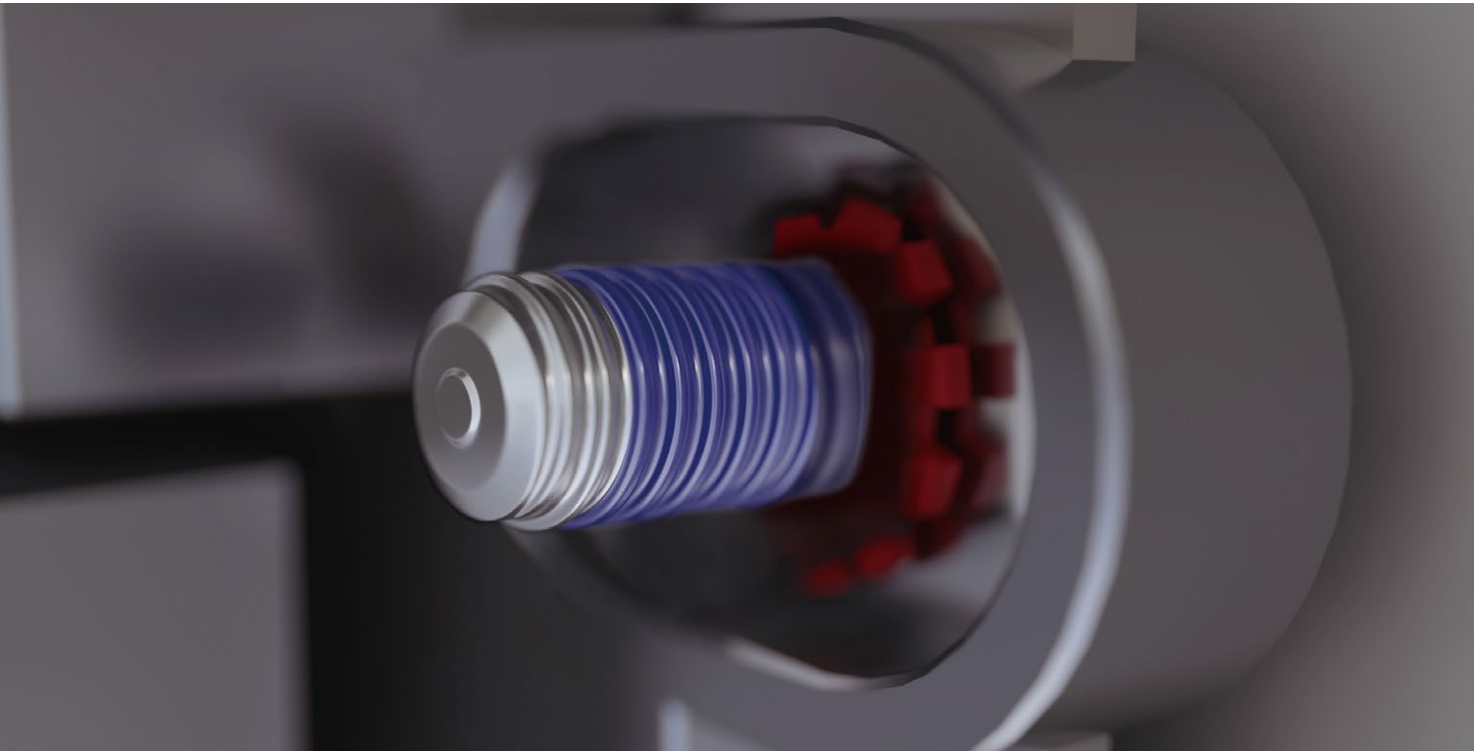
产品名称	描述	化学性	颜色	固化速度	应用	储存温度
LOCTITE 3614	为在波峰焊接前粘接表面贴装元件和印刷电路板设计	环氧胶	红色粘稠凝胶	150 °C 90-120秒	表面安装 粘合剂	2 – 8 °C
LOCTITE 3627	为在波峰焊接前粘接表面贴装元件和印刷电路板设计	环氧胶	红色类凝胶材料	150 °C 90-120秒	表面安装 粘合剂	2 – 8 °C
LOCTITE 3616	为在波峰焊接前粘接表面贴装元件和印刷电路板设计	环氧胶	红色粘稠凝胶	150 °C 90-120秒	表面安装 粘合剂	2 – 8 °C
LOCTITE ABLESTIK 84-3J	为芯片粘接应用和元件粘接设计的粘合剂	环氧胶	蓝色	150 °C, 1小时 125 °C, 2小时	芯片粘接	-40 °C
硅胶						
LOCTITE SI 5699	主要为法兰密封设计。在刚性法兰如变速箱和铸造金属外壳上具有出色的耐油性	脲硅胶	灰色膏	25 °C / 50±5 % RH 固化1周	密封	8 – 21 °C
LOCTITE SI 5404	为粘接金属散热片、陶瓷芯片和电路板基材设计	有机硅	白色至灰色膏	150 °C 1小时	粘接	2 – 8 °C

导热粘合剂

产品名称	描述	固化种类	导热性 (W/m·k)	体积电阻率 (Ω·m)	固化方式	保质期
丙烯酸						
LOCTITE 315	自动控制厚度，导热单组份粘合剂，适用于将电子元件与散热器之间的粘接	活化剂(7387)	0.81	1.3 x 10 ¹²	20 °C 24-72小时	5 °C, 9个月
LOCTITE 384	可维修室温固化导热粘合剂，适用于可拆卸的零件	活化剂(7387)	0.76	1.3 x 10 ¹²	20 °C 24-72小时	5 °C, 9个月
硅胶						
BERGQUIST® LIQUI BOND TLB SA2005RT	双组份高性能硅胶导热粘合剂	双组份	2.00	1.0 x 10 ¹³	25 °C, 7天或 85 °C, 1小时	5 – 25 °C, 6个月

螺纹锁固胶

产品名称	描述	化学品	颜色	固化速度	25 °C粘度 (cP)
丙烯酸					
LOCTITE 243	中等强度多用途螺纹锁固粘合剂。该螺纹锁固胶可以固定并密封螺栓、螺母和螺柱，避免由于振动导致的松脱	丙烯酸	蓝色	24小时	1,300 – 3,000



美洲

美国

Henkel Corporation
14000 Jamboree Road
Irvine, CA 92606
United States
电话 : +1.888.943.6535
传真 : +1.714.368.2265

Henkel Corporation
20021 Susana Road
Rancho Dominguez, CA 90221
United States
电话 : +1.310.764.4600
传真 : +1.310.605.2274

Henkel Corporation
18930 W. 78th Street
Chanhassen, MN 55317
United States
电话 : +1.952.835.2322
电话 : +1.800.347.4572
传真 : +1.952.835.0430

巴西

Henkel Brazil
Av. Prof. Vernon Kriebel, 91
06690-070 Itapevi, Sao Paulo
Brazil
电话 : +55.11.3205.7001
传真 : +55.11.3205.7100

亚太区

大中华

汉高管理中心
中国上海市杨浦区江湾城路99号
尚浦中心7幢 200438
电话 : +86.21.2891.8000
传真 : +86.21.2891.8952

爱博斯迪科化学(上海)有限公司
中国上海市浦东新区外高桥自贸区
美桂南路332号 200131
电话 : +86.21.2702.5888
传真 : +86.21.5048.4169

Henkel Taiwan Ltd.
10F, No. 866, Zhongzheng Road,
Zhonghe District, New Taipei City, 23586
Taiwan
电话 : +866.2.22271988
传真 : +866.2.22268699

日本

Henkel Japan Ltd.
27-7, Shin Isogo-cho
Isogo-ku Yokohama, 235-0017
Japan
电话 : +81.45.286.0161
电子邮箱 : jp.ae-csdesk@henkel.com

韩国

Henkel Korea Co., Ltd.
18th floor of tower B, BYC High City Bldg
Gasan Digital 1-ro, Geumcheon-gu,
Seoul, 08506
South Korea
电话 : +82.2.6150.3000
传真 : +82.2.6947.5203

新加坡

Henkel Singapore Pte Ltd.
401, Commonwealth Drive
#03-01/02 Haw Par Technocentre,
Singapore 149598
电话 : +65.6266.0100
传真 : +65.6472.8738 / +65.6266.1161

欧洲

比利时

Henkel Belgium N.V.
N.V. Nijverheidsstraat 7
B-2260 Westerlo
Belgium
电话 : +32.1457.5611
传真 : +32.1458.5530

英国

Henkel Ltd.
Adhesives Limited Technologies House
Wood Lane End
Hemel Hempstead
Hertfordshire HP2 4RQ
United Kingdom
电话 : +44.1442.278000
传真 : +44.1442.278071

Across the Board,
Around the Globe. 

henkel-adhesives.com/electronics
henkel-adhesives.com/thermal



扫一扫, 了解更多
汉高电源及工业自动化解决方案